PAT - NO:

JP356152582A

DOCUMENT - IDENTIFIER:

JP 56152582 A

TTTLE:

ELECTRODEPOSITED GRINDSTONE

PUBN - DATE:

November 26, 1981

INVENTOR - INFORMATION: NAME SUZUKI, TAKASHI UEDA, SHUJI TANNO, MASUO

ASSIGNEE - INFORMATION:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP55055969

APPL - DATE :

April 25, 1980

INT-CL (IPC): B24D003/06

ABSTRACT:

PURPOSE: To control the eutectic amount of abrasive grains with respect to a plating metal and manufacture a grindstone corresponding to the grinding performance, by making the abrasive grains hydrophilic, and uniformly dispersing them in a plating bath.

CONSTITUTION: Minute abrasive grains, the order of 3∼ 30μ in diameter, of diamond, cubic system boron nitride, silicon carbide or the like are stirred in a cationic surface active agent in order to make them hydrophilic. Said abrasive grains are dispersed into a plating bath of nickel, copper or the like and depoisited on the cathode alloy by electrolysis

simultaneously with the metal .

COPYRIGHT: (C)1981,JPO&Japio

DERWENT - ACC - NO:

1982-03204E

DERWENT - WEEK:

198202

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Abrasives prodn. - by coating

abrasive particles with

surfactant, dispersing in

electroplating soln. and

electrodepositing on metal plate

PATENT-ASSIGNEE: MATSUSHITA ELEC IND CO LTD[MATU]

PRIORITY-DATA: 1980JP-0055969 (April 25, 1980)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

LANGUAGE

PUB - DATE

PAGES

MAIN-IPC

JP 56152582 A

November 26, 1981

N/A

003

N/A

N/A

JP 88033988 B

July 7, 1988

N/A

000

APPLICATION - DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL - DATE

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 56152582A

JP **56152582**A

N/A

1980JP-0055969

April 25, 1980

INT-CL (IPC): B24D003/06

BASIC-ABSTRACT:

Abrasives are produced using an electro-depositing method, from diamond, boron

nitride or other hard particles. diamond particles, cubic system B nitride

particles, Si carbide particles or other fine abrasive particles of 3-30

microns are added to a cation type surfactant soln. and mixed with each other

for a few hrs. to coat the surface of each particle with surfactants. The

surface of the particles is rendered lyophilic.

lyophilic particles are dispersed in a Ni, Cu, Zn, Cr etc. metal electroplating soln. and an electro-depositing process is carried out on e.g. a Fe or Cu (alloy) base plate which is mounted on the cathode in the electro-plating soln. bath, so that the fine particles are deposited in the electro-deposited metal layer.

The deposition amt. of abrasive particles and the thickness of the deposited metal layer is controlled. The adhesion of the particles to the deposited metal is increased.

TITLE-TERMS: ABRASION PRODUCE COATING ABRASION PARTICLE SURFACTANT DISPERSE

ELECTROPLATING SOLUTION ELECTRODEPOSIT METAL

PLATE

ADDL - INDEXING - TERMS:

DIAMOND BORON NITRIDE SILICON CARBIDE CATION LYOPHILIC IRON@

COPPER@ ALLOY NICKEL COPPER ZINC CHROMIUM NICKEL@ ZINC@ CHROMIUM@

DERWENT-CLASS: LO2 M11 P61

CPI-CODES: L02-F; L02-F03; M11-F;

(19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭56—152582

⑤Int. Cl.³ B 24 D 3/06 識別記号

庁内整理番号 6660-3C 砂公開 昭和56年(1981)11月26日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

匈電着砥石

②特

願 昭55-55969

②出 願 昭55(1980) 4 月25日

⑩発 明 者 鈴木隆

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑫発 明 者 上田修治

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑫発 明 者 丹野益男

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

⑪代 理 人 弁理士 中尾敏男

外1名

明 細 特

1、発明の名称

電着砥石

2、特許請求範囲

タイヤモンド、立方晶窒化ホウ素等の微小砥粒をカチオン系界面活性剤により親水性を帯びさせてニッケル、銅等の電気めっき浴に分散させ、電解することによって陰極上の台金上に金属と砥粒とを同時に析出させて製作することを特徴とする電着砥石。

3、発明の詳細な説明

本発明は電着砥石の改良に係り、電着砥石を製作する上でダイヤモンド、立方晶窒化ホウ素等の 砥粒にカチオン系界面活性剤により親水基を付加 させ電気めっき浴における分散を良くすることで、めっき金属に対する砥粒の共析量を一定量に制御し、研削性能に合わせた電着砥石を製作することを目的とする。

従来の電着砥石の製法としては、1 ダイヤモンド等の砥粒をただ単にめっき浴に懸濁させ、めっ

き浴の下方に置いた台金上に砥粒を沈積させ、そ の後に電解めっきで結合し、余分な砥粒は払い落 **す方法がある。この方法ではダイヤモンド等の砥** 粒の配合比の調整が不可能である。 2 ダイヤモン ド等の砥粒に予め化学銅めっき又は化学ニッケル めっきを旋し、それを電気めっき浴中に懸濁させ て電解めっきを行う方法もあるが、この方法では 第一段階での化学めっきの砥粒に対する密着性が 良いとは言えず、結合力が良くない。3砥粒を周 知の接着剤で台金に接着し、先ず化学めっきを下 地めっきとして処理した後で、電解めっきを行っ て固定する方法がある。しかし接着剤の耐熱性が なく、研削時に発生する熱によって接着強度が弱 まること。又砥粒面に化学めっき及び電気めっき を施すため、研削面を出す必要性から必ずドレッ ンングの後加工が必要である。

以上従来の電着砥石の製作法では欠点が多くある に加え、最適の工法がまだ固まっていない問題が あった。

本発明はダイヤモンド等の砥粒を親水化して、

めっき浴に均一に分散させることにある。又電解めっき浴中で陰極上に析出させるためには陰極への電気泳動が良くてはならない。以上の条件を満すものとしてカチオン系界面活性剤を使用した。
グイヤモンド等の砥粒、粒径3~30μのもの約19を約500のカチオン系界面活性剤中で数時間攪拌して、砥粒表面を界面活性剤で包んで親水化した。めっき浴に添加する場合には前述の溶液状のもので行った。

以下実旋例について述べる。

実旋例1

台金の材質が鉄、銅、銅合金の場合には通常の 前処理口程を行った後で下記のめっき浴でダイヤ モンド砥石を製作した。

6

及び電流密度の増加に従って増加する傾向にある。 第2図から攪拌の有無の差はほとんどなくカチオン系界面活性剤の分散効果が著るしいことを示す。 実旋例2

実旋例1では一般にワット浴と言われるニッケルめっき浴について示したが、スルファミン酸ニッケルめっき浴においてもダイヤモンド砥石の製作が可能である。その条件を下記に示す。

条件 pH:1~4

温度:50~607

電硫密度:1~10A/clm*

攪拌:マグネットスターラー

結果はワット浴とほぼ同じものを得ることができた。

实旋例3

条件 pH:2~4

温度:40~50℃

電流密度: 1~ 5 A/clm

攪拌:マグネットスターラー

台金がステンレスの場合には上記めっき浴で、 めっきを行う前に下記の塩化ニッケル浴で下地め っきを旋した後で実旋した。

浴組成 塩化ニッケル 240g/l

塩酸

1209/1

条件 p H: 2.0

温度:20~30℃

電流密度: 3~5 A/clm

時間:1分

その時のダイヤモンドの添加量及び電流密度に対するダイヤモンドの析出量の関係を第1図に示す。但し通常ダイヤモンド砥石の場合ダイヤモンド4.4 カラット/cml の時を集中度100として示すのでそれに従って表示した。又めっき浴を攪拌した時としない時の違いを第2図に示す。第1図からダイヤモンドの添加量はダイヤモンドの添加量

6

実旋例1、2ではニッケルめっきに関して示したが銅めっきでも実旋可能である。

条件 温度: 25~30 c

電流密度:1~5A/clm

以上実旋例に記述しなかったがこの方法はニッケル、銅以外にクロム、亜鉛等のめっきについても可能であり、砥粒としてはダイヤモンド以外の立方晶窒化ホウ素、炭化ケイ素等についても応用可能である。

上記各実旋例により示した本発明は、下記のよ 5 な顕著な効果を奏する。

1、ダイヤモンド等の砥粒の析出量の制御可能2、金属イオンとの共析めっきで密着力が良い

3、厚付けめっきが可能

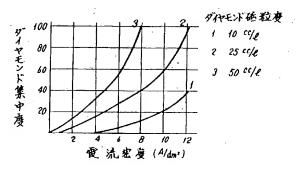
4、種々のタイプの砥石の製作が可能

4、図面の簡単な説明

第1図はダイヤモンド析出量を示す図、第2図

はカチオン系界面活性剤の効果を示す図である。 第 1 図

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名



第 2 図

